

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年9月28日(28.09.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/182071 A1

(51) 国際特許分類:

C08G 73/10 (2006.01) C08K 5/49 (2006.01)
C08K 5/092 (2006.01) C08L 79/04 (2006.01)
C08K 5/17 (2006.01) C08L 79/08 (2006.01)
C08K 5/23 (2006.01) G03F 7/004 (2006.01)
C08K 5/28 (2006.01) G03F 7/037 (2006.01)
C08K 5/42 (2006.01)

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/009813

(22) 国際出願日: 2023年3月14日(14.03.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-046353 2022年3月23日(23.03.2022) JP

(71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 青島 健太 (AOSHIMA Kenta); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 一瀬 恵子 (ICHINOSE Keiko); 〒4558502 愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東レ株式会社 名古屋事業場内 Aichi (JP). 荒木 斉 (ARAKI Hitoshi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 浅野 到 (ASANO Itaru); 〒4558502 愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東レ株式会社 名古屋事業場内 Aichi (JP). 莊司 優 (SHOJI Yu); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 酒井 智基 (SAKAI Tomoki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

(54) Title: RESIN COMPOSITION, CURED PRODUCT, ELECTRONIC COMPONENT, AND DISPLAY DEVICE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、硬化物、電子部品および表示装置

(57) Abstract: A resin composition containing (A) a soluble resin, (B) an organic salt, and (C) a solvent, wherein the (B) organic salt is formed from a carboxy-group-containing organic compound and an amino-group-containing organic compound, and the (B) organic salt is 0.01-10 parts by mass per 100 parts by mass of the (A) soluble resin. Provided is a resin composition having exceptional substrate adhesion and exceptional storage stability.

(57) 要約: (A) 可溶性樹脂、(B) 有機塩および(C) 溶剤を含有する樹脂組成物であって、前記(B) 有機塩がカルボキシ基を有する有機化合物と、アミノ基を有する有機化合物から形成される有機塩であって、前記(A) 可溶性樹脂100質量部に対して、前記(B) 有機塩が0.01~10質量部である樹脂組成物。基板密着性に優れ、かつ保存安定性に優れた樹脂組成物を提供する。

WO 2023/182071 A1